

フィルムラミネーター
(保護フィルム貼り付け装置)
Wafer Backlapping Film Applicator
Model UH108



ウェハーに気泡を残さず、
バックラインドテープを
貼付け、ウェハーエッジに
沿ってテープをカットする
保護テープラミネートに
最適です。

USI ULTRONICS, INC.
株式会社ウルトロニクス

Wafer Backlapping Film Applicator



Wafer Backlapping Film
Applicator

Model **UH108**

フィルムラミネーター（保護フィルム貼り付け装置）

モデルUH-108及びUH-108-12は、ウェハーバックグラインド時、ウェハー表面への保護フィルムを貼る装置です。テーブルトップ型のシンプルな装置で、独自の構造によるフィルムカット機構採用により、ウェハーエッジに沿った高精度なフィルム切断が可能です。ウェハーエッジでのフィルムカット精度も、エッジより120ミクロン以内、作業時間も20秒以内です。モデルUH-108は、3,4,5,6インチ仕様でオリフラタイプ、UH-108-12は、8インチ、12インチ仕様でノッチタイプとなります。その他各種オプションも揃えております。ダイボンディングシート（DAF=ダイアタッチフィルム）テープの貼り付けにも威力を発揮します。



特長

- テープの貼り付け後、特殊カッターにより、ウェハーのエッジに沿って、容易にカットが出来る上、高いカット精度（0.127 μ 以内）が得られます。
- ラミネート時における気泡の発生が無く、均一な貼り付けが可能です。
- ローラーの圧力調整が容易です。
- セパレーター巻取機構付。
- ウェハーサイズ 3"~6"迄、及び8"~12"対応。

機種

- Model UH108 3インチ~6インチまで対応
- Model UH108-12 8インチ~12インチまで対応



ダイシングテープ、UVテープ各種取り揃えております。仕様、価格等はお問い合わせください。



株式会社 ウルトロニクス

〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-2
TEL:(0467)24-5137 FAX:(0467)24-5122

E-mail sales@ultronics.co.jp URL <http://www.ultronics.co.jp>